

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海璞远：魏来；厦门纵横金鼎：冯浚浚；陕西德盈：阚皓丞、滕世轩；宇昂基金：张亮；宁聚投资：张雷；锦绣中和：徐界；国弘天下：孙世文、孙世怡；南方基金：周简之；华泰证券研究所：张迪；华泰证券：季晨曦、叶昕昕、朱兵、沈晶晶、任宪亮
时间	2023年11月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>通富微电主要从事集成电路封装测试业务，公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地；2021 年，公司新增第七个封测基地——通富通科，位于南通市北高新区；2023 年，通富通科、南通通富三期工程、通富超威苏州、通富超威槟城新工厂等一批公司重大项目建设稳步推进，积极</p>

为未来扩大生产做好充足准备。目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面。先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年前三季度分别实现营收 107.69 亿元、158.12 亿元、214.29 亿元和 159.07 亿元。公司 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年前三季度的归母净利润分别为 3.38 亿元、9.57 亿元、5.02 亿元和-0.64 亿元。

二、行业情况

半导体是信息技术和电子产业的核心基础，其市场规模和发展趋势反映了全球经济和科技的变化。根据半导体行业协会 (SIA) 的数据，2023 年第一季度全球半导体销售额为 1,195 亿美元，较上季度下降 8.7%，较去年同期下降 21.3%；2023 年第二季度全球半导体销售额为 1,245 亿美元，环比增长 4.7%，同比减少 17.3%；2023 年第三季度全球半导体销售额为 1,347 亿美元，环比增长 6.3%，同比下降 4.5%。其中，2023 年 9 月的全球销售额比上月增长 1.9%，这是全球芯片销售额连续第七个月实现环比增长。从 2023 年目前的数据看，全球半导体市场持续回暖。

集成电路是半导体产业的重要组成部分，其产业规模远超半导体其他细分领域，具备广阔的市场空间和增长潜力。赛迪顾问的报告预测，2025 年全球集成电路市场销售额可达 7,153 亿美元，2022 年至 2025 年期间保持 10% 以上的年均复合增长率。随着国产化率的不断提升以及终端市场需求的增加，到 2025 年中国大陆集成电路销售额将达到 19,098.80 亿元，较 2021 年增长 82.62%。长远来看，集成电路产业的发展，未来可期。短期来看，公司 2023 年生产经营“挑战与机遇”并存，挑战是公司可能会面临行业触底过程中的阵痛，机遇是行业新技术（Chiplet 等先进封装新技术）、新应用（ChatGPT 等人工智能新应用）带

来的广阔发展空间。

三、公司发展优势

半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。目前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司面向未来高附加值产品及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

2023 年上半年，全球半导体市场陷入低迷，终端市场需求疲软，下游需求低于预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务遭遇较大挑战。面对困难，公司进一步优化传统封测市场和产品策略。一是紧跟手机等消费类市场变化，积极调整市场策略，稳定并提升了市场占有率；二是抓住 5G 高端手机对 RFFEM 等产品需求增长的机遇，借助成熟的系统级（SiP）封装技术和高性能的引线互联封装技术等，快速实现射频模组、通讯 SOC 芯片等产品大批量国产化生产，增加营收的同时也获得了来自 MTK、紫光展锐、卓胜微等重要头部企业的高度认可。同时，公司积极调整产品布局，立足市场最新技术前沿，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长。2023 年上半年，公司在存储器（Memory）、显示驱动（Display Driver）、功率半导体（Power）等方面取得重要突破。随着国内存储芯片技术的日趋成熟以及国产面板

在全球市场份额的提升,公司布局多年的存储器产线和显示驱动产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。由于全球能源结构调整已成为必然趋势,而这一趋势也带动了功率半导体及大功率模块需求的持续增长。凭借在功率半导体封测领域的多年实践,上半年公司配合意法半导体(ST)等行业龙头,完成了碳化硅模块(SiC)自动化产线的研发并实现了规模量产,在光伏储能、新能源汽车电子等领域的封测市场份额得到了稳步提升。通过并购,公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式,建立了紧密的战略合作伙伴关系;AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购,实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局,双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性,有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司是AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,未来随着大客户资源整合渐入佳境,产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

公司凭借有效的成本控制,先进的技术管理能力以及快速响应和优质交付等方面的优异表现连续三年荣获德州仪器(TI)“卓越供应商”奖项。通富超威苏州获得多家客户2023半年度质量评分一级供应商称号,连续5次在AMD供应商季度质量评分中获得第一名。合肥通富被多家重要客户评为A级优秀供应商。

公司在汽车电子领域深耕20余年,与国际一流汽车半导体厂商深度合作,积累了丰富的相关经验,在汽车电子领域的份额占比保持领先,并逐年提升。公司以汽车电子新专线建设为抓手,进一步加大工程资源投入,优化产线管理体系,与国内外汽车电子客户共同成长。

公司将面向高端处理器等产品领域进一步加大研发力度:大力投资2.5D/3D等先进封装研发,积极拉通Chiplet市场化应用,提前布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台,拓展先进封装产业版图,为新一轮的需

	<p>求及业务增长夯实基础，带动公司在先进封装产品领域的业绩成长。</p> <p>四、2023年前三季度业绩情况</p> <p>2023年前三季度，公司积极调整产品布局，立足市场最新技术前沿，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，公司实现营业收入159.07亿元，同比增长3.84%。</p> <p>第三季度，随着市场需求回暖各项业务陆续回升，公司盈利能力逐步改善，加之公司加强外汇管控措施，降低汇兑损失；公司第三季度实现归母净利润1.24亿元，经营成效改善显著。其他2023年三季度详细情况，可以关注公司对外披露的《2023年第三季度报告》。</p>
附件清单(如有)	—
日期	2023年11月10日